

ご使用におけるお知らせ

平素は弊社製品ハッコーFX-301をご愛用いただき、ありがとうございます。

ハッコーFX-301は錫-鉛共晶はんだをご使用される場合、はんだ槽内のはんだ量が減ると、下記の症状が発生いたします。

電源投入後、はんだが溶融する直前に溶融はんだが飛散する怖れがあります。

この症状は、はんだ液面がはんだ槽の最上面から6～12mm程度低い位置にある状態で発生いたします^{※1}。お客様におかれましては、はんだ液面をはんだ槽の最上面～5mm以内まででご使用されますようお願い申し上げます。

※1 諸事情により、飛散条件下でご使用される場合は、飛散防止カバーの設置をお願い申し上げます。
なお、飛散防止カバーはハッコーFX-301付属品“除去プレート”と合わせてご使用ください。また、設置した飛散防止カバーは大変高温となりますので、使用時及び使用後、保管の際にはご注意ください。

使用時的請求

承蒙惠顧HAKKO FX-301 熔錫爐

HAKKO FX-301 錫鉛錫使用時，如果錫槽里的焊錫容量減少會發生如下狀況。開電源之後在焊錫溶解之前開始溶化的焊錫會發生飛散。當錫面在離焊錫槽最高面6～12mm 左右的位置時發生此症狀。^{※1}
使用時請讓焊錫在錫槽最高面下5mm 以內的範圍內使用。

※1 由於以上原因，飛散情況下使用時，請設置飛散防止套板。並且飛散防止套板和 HAKKO FX-301 附件“除去板”，請一起使用。設置之後飛散防止套板會溫度變高，使用時及使用後保管之際請注意。

Notice when in use

Thank you for choosing HAKKO FX-301.

If using eutectic solder, HAKKO FX-301 will have the following symptoms occurring when the amount of solder in the solder pot is less.

Molten solder will spatter after turning ON the appliance, just before the solder melts.

This symptom is seen when the solder is from 6 to 12mm below the top surface of the solder pot.*

Please use HAKKO FX-301 with solder filled above 5mm (0.2 inch) from the top surface of the solder pot.

* Please attach the spatter prevention cover if using HAKKO FX-301 under the condition that molten solder spatters. Please use the spatter prevention cover with the attached spatula. Also, the spatter prevention cover can be very HOT. Please handle with care.

